

第十六届全国固体薄膜学术会议征文通知（第二轮）

（2018. 12. 10-2018. 12. 13 海南海口）

主办单位：

中国电子学会电子材料学分会、半导体与集成技术分会

承办单位：

海南师范大学、海南师大教育服务有限公司教育培训中心

协办单位：

中国科学院纳米器件与应用重点实验室、海南省物理学会、海南省人工智能学会

由中国电子学会电子材料学分会、半导体与集成技术分会主办，海南师范大学和海南师大教育服务有限公司教育培训中心联合承办的“第十六届全国固体薄膜学术会议”将于2018年12月10日至13日在风景优美的海南省海口市召开。全国固体薄膜学术会议是两年一次的全国性重大学术活动，将展示固体薄膜及相关领域中各方面的发展与最新成果，探讨国际上固体薄膜的研究及产业现状和发展趋势。召开这次会议的目的是为国内从事固体薄膜领域的研究、教学、生产的科技人员、工程技术人员及管理人员提供一个学术与技术交流的平台，促进我国该领域的科学技术进步和产业发展。我们热忱欢迎全国广大固体薄膜材料及器件科技工作者、仪器设备厂商踊跃投稿参会、参展并作相关专题报告。

一、大会主席、副主席

主 席：杨 辉

副主席：叶志镇

二、程序委员会

主 任：沈 波

副主任：徐 科 彭鸿雁

委 员：（排名不分先后）

韩杰才、杨德仁、叶志镇、吕文中、唐成春、陈 弘、张志刚、黄富强、黄 丰、张书明、张耿民、刘兴钊、王占杰 、李阳平、朱嘉奇、沈卓身、赵德刚、孙元平、沈晓明、张维连 、陈贵锋、张景文、成步文、董显林、步云英、沈浩平、夏传钺、张 彤、宋群厚、张慧国、王林军、朱丽萍、黄靖云、林 健、王晓亮、张宝平、张宝顺、丁孙安、孙 钱、秦 华、刘建平、冯志宏、刘益春、申德振、陆书龙、边历峰、杜小龙、胡超权、林吉、王艺臻、张铁民、姚仲瑜

三、大会组织委员会

主 任： 彭鸿雁

副主任： 张书明、林吉

成 员： 潘孟美、张铁民、费红阳、王德波、吕栋栋

四、征文范围：

- 1、薄膜科学与技术展望
- 2、薄膜生长制备、特性表征及应用研究
- 3、薄膜生长机理、动力学研究及模拟计算
- 4、薄膜表面、界面及微结构研究
- 5、新型固体薄膜相关技术研究
- 6、纳米薄膜材料及低维结构
- 7、磁性薄膜、多层膜、颗粒膜、超薄膜的制备及特性研究
- 8、薄膜传感端的制备及特性研究
- 9、薄膜器件制备及特性研究
- 10、薄膜生长设备及测试设备
- 11、其他薄膜材料及器件相关内容

五、会议论文内容及格式要求

1. 符合征文要求内容的论文摘要。
2. 论文摘要主题突出，内容层次分明，数据准确，论述严谨，结论明确，采用法定计量单位。
3. 为保证会议论文集质量，请投稿者按照论文格式要求撰写。排版顺序为：题目用三号黑体字，作者用四号楷体字，单位、邮编、摘要、关键词等用六号宋体字，正文用五号宋体字。
4. 摘要截止日期： 2018 年 11 月 20 日
5. 征文投稿请通过电子邮件发送至：nctsf2018@163.com，邮件的主题请注明“第十六届全国固体薄膜学术会议征文”，并在邮件中附上来稿人详细通讯地址、E-mail 地址及联系电话等信息。
6. 被录用的论文将向作者通过 E-mail 发送参加会议正式通知。
7. 会议将与《半导体学报》合作，遴选优秀论文在《半导体学报》发表。

六、会议地点及住宿：

会议地点：海南新燕泰大酒店

地 址：海南省海口美兰区五东路 18 号，

会议住宿：海南新燕泰大酒店

会议期间统一安排食宿，费用自理。由于会议期间是海南省旅游旺季，住宿和交通可能比较紧张，请参会代表尽早预定参会往返机票（车票），酒店给会议预留房间有限，请及早确认。

七、会议注册费：

普通代表 2800 元人民币，学生代表 2000 元人民币。

参会代表可以提前通过银行转账方式或者现场缴费方式缴纳会议注册费。现场缴费接受现金或刷卡方式。会议委托海南师大教育服务有限公司教育培训中心代收会务费并开具会务费发票。

通过银行转账缴费到以下账户：

开户名：海南师大教育服务有限公司教育培训中心

开户行：工行海口海师支行

账 号：2201003609200023849

通过银行转账请注明“缴费单位+姓名+固体薄膜会议费”字样，转账完成后请保留转账单，到会场换取注册费发票。

提前 10 天缴费的代表可以优惠会议注册费 100 元人民币。

八、会议网站及联系人

会议网站：<http://t.cn/E7BPPfX>

会议秘书组邮箱：nctsf2018@163.com

会议联系人：潘孟美 电话：13876373255 邮箱 2461972453@qq.com

费红阳 电话：18004440833 邮箱 616531717@qq.com

通讯地址：海南省海口市龙昆南路 99 号 邮编：571158

第十六届全国固体薄膜学术会议组委会

(电子材料学分会代章)

2018 年 10 月 10 日

